

证券代码：688220

证券简称：翱捷科技

翱捷科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-1223

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他	
参与单位名称	(排名不分先后) 长城基金、嘉实基金、华泰柏瑞、西部利得、长盛基金、鹏华基金、长江电子、东方证券、国信证券、广发证券、华泰电子	
时间	2025 年 12 月 17 日至 12 月 23 日	
上市公司接待人员姓名	董事长、首席战略官	戴保家
	董事、副总经理	赵锡凯
	董事、董事会秘书、副总经理	韩旻
	投资者关系总监	董跃飞
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>问：阿里网络目前减持情况，后续是否还有新的减持计划？</b></p> <p>答：截至 2025 年 12 月 18 日，阿里网络所持公司 3%股份的减持计划已全部实施完毕。本次减持完成后，阿里网络仍持有公司 12.43%的股份，为公司重要股东。阿里网络系公司早期股东，自 2017 年起已参与公司多轮融资。本次减持是其基于自身商业安排作出的决策，并非不看好公司未来发展。截至目前，公司尚未获悉阿里网络存在新的减持计划。</p> <p><b>问：公司 5G RedCap 芯片的最新市场进展情况如何？</b></p> <p>答：5G RedCap 是公司重点布局的增量业务，4G 到 5G</p>	

	<p>物联网迁移是必然趋势。公司针对模组类/车载类/MiFi 类、轻量化可穿戴、智能可穿戴/智能终端三大市场已经分别推出了三个平台，现已有近 10 款芯片商用，50 多个终端产品项目正在稳步推进中，第四季度开始已经有多家客户开始批量上量比如中兴、飞猫等。随着 5G 基础设施建设持续完善、5G 网络商用价值逐步显现，2026 年 5G RedCap 市场将迎来规模化增长机遇，公司相关产品出货量有望突破百万级规模。</p> <p><b>问：明年公司对收入展望如何？具体会来源于哪些业务方向？</b></p> <p>答：公司对明年收入整体持乐观态度，收入将主要来源于以下部分：</p> <p>1. 4G 蜂窝物联网业务：公司在该领域已建立稳固的市场地位与深厚的客户基础，凭借成熟的产品体系与持续的客户粘性，2026 年仍将作为公司收入的核心支柱，为业绩提供稳定支撑。</p> <p>2. 5G RedCap 业务：公司已完成该领域全产品线布局，当前项目储备充足，多个合作项目已成功落地并实现批量出货。随着 5G 网络基础设施持续完善、行业应用场景加速渗透，市场逐步进入增长阶段，该业务收入有望实现稳步提升。</p> <p>3. 5G eMBB 业务：近期，公司已成功斩获客户订单，从 2026 年 Q1 开始有望实现大规模出货。</p> <p>4. 智能手机 SoC 业务：自 2023 年年末开始，公司以每年推出一款产品的频次，连续推出多款智能 SoC 芯片，包括 4G4 核、第一颗 4G8 核、第二颗 4G8 核芯片，另外第一颗 5G 智能手机 SoC 芯片也已经在 9 月份流片即将回片。经过 2024 年、2025 年的市场推进，相关产品已经逐步实现商业化落地，终端场景除了智能手机外，还拓展至了智能车机、</p>
--	---

	<p>智能平板、智能可穿戴等多类终端应用场景，出货规模逐步提升。目前仍有多个项目正在推进且进展顺利，预计 2026 年将继续放量增长。</p> <p>5. 芯片定制业务：公司当前在手订单储备丰富，2026 年随着相关项目逐步交付，NRE（工程开发费）收入将逐步确认，该业务收入实现大幅增长的确定性较高。</p> <p><b>问：公司在人工智能领域是否有技术储备，技术水平如何？</b></p> <p>答：在人工智能领域，公司已经构建起了深厚的技术储备，主要体现在以下几个方面：</p> <p>1. <b>全栈自主研发：</b>公司的 AI 研发团队具备全栈式开发能力，能够从硬件加速器、算法优化，到软件栈和工具链进行一体化设计。</p> <p>2. <b>灵活强大的 NPU 架构：</b>公司拥有自研的 NPU IP，可支持 CNN（卷积神经网络）、RNN（循环神经网络）、Transformer 等主流 AI 模型，同时具备极高的算力灵活性，覆盖范围可从 1 TOPS 以下到数十 TOPS 的算力需求，可灵活匹配不同产品的性能需求。</p> <p>3. <b>广泛的应用适配：</b>公司的 AI 能力既能满足智能手机、平板电脑等消费电子产品的端侧 AI 需求，也能胜任云端边缘推理任务，同时支持与 3D 堆叠等先进存储技术融合，进一步提升处理效能，拓展了 AI 技术在复杂场景下的应用可能性。</p> <p><b>问：公司之前流片的 5G 进度如何？</b></p> <p>答：公司的 5G 智能 SoC 芯片已经于 2025 年 9 月流片，预计本月底前回片。</p>
--	---

	<p><b>问：公司 ASIC 定制业务在手订单情况，对 2026 及 2027 年定制业务收入如何展望？</b></p> <p>答：公司 ASIC 定制业务在手订单充足，且均为先进制程项目，复杂度高、单个订单规模较大。从目前在手订单及项目进展的情况来看，对于 2026 及 2027 年，公司对后续 ASIC 定制业务的收入确认持乐观态度。</p> <p><b>问：公司 ASIC 业务主要服务的客群大概是什么领域的？公司承接相关业务的原则是什么？业务是否具有可持续性？</b></p> <p>答：公司芯片定制业务覆盖云侧 AI 算力、端侧可穿戴及 RISC-V 等多个核心应用领域的头部客户，客户种类多元化。公司在承接相关业务时，会根据客户实力、项目规模、项目合规性、后续量产可能性及量产规模等因素向上综合考虑，优先选择 CSP 厂商、系统厂商等头部客户。目前芯片定制业务需求旺盛，而公司作为平台级芯片企业，有深厚的技术积累和丰富的先进制程量产经验，是目前国内芯片定制业务领域的龙头企业，业务承接可持续性强。同时，公司主要承接 Turn-key 式一站式服务，在 NRE（工程开发费）部分完成后，公司继续负责客户后续量产业务，这会持续为公司带来业务收入。</p> <p><b>问：华为公布的昇腾 Roadmap 中，950 预计会涉及 HMC 等新型的存储方案，公司是否在这方面有相关的储备和项目？</b></p> <p>答：公司在云端 AI 推理的 ASIC 项目中，在满足合规性要求的基础上，针对不同客户的定制需求，开发了多种方案，既有高性价比的 LPDDR 方案来满足大规模应用，也有 3D DRAM 接口在内的先进封装技术来满足超高带宽应用，覆盖</p>
--	---

	<p>了当前市场主流技术解决路径。</p> <p><b>问：公司近期是否有通过并购来增强技术实力的计划？</b></p> <p>答：公司持续关注资本市场合作，并会根据自身的战略规划及发展需要，积极评估和把握并购重组的机会。截至目前，公司无相关计划。</p> <p><b>备注：</b>需特别说明的是，本次交流活动问答回复中，所有关于未来业务发展的预期，因预测周期距当前时点尚有一定时间跨度，政策环境、市场情况、项目进度等客观因素可能存在动态变化，具体数据以当年审计数字为准，请投资者注意投资风险。</p>
附件清单 (如有)	无